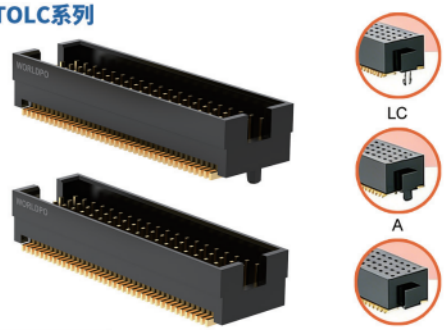
## 高速板对板连接器

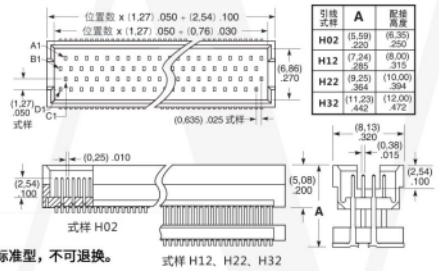
### WTOLC系列



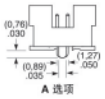

## 产品技术参数

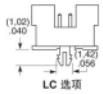
| | |
|---|---|
| 绝缘体材料:黑色液晶聚合物 | 触点电阻:10mΩ |
| 触点材料:磷铜 | 插入深度:(1.68mm).066"至(3,61 mm).142"与 (0,38 mm).015"擦接 |
| 电镀:在50μ"(1.27μm)的镍上镀金 | |
| 额定电流:2.54A每针@周围环境80°C | 插入力:(仅限单触点)平均为2.0oz (0,56N) |
| 工作温度范围:-55°C至+125°C | 正交力:平均为75克(0.74N) |
| 可无铅焊接:是 | 拔出力:(仅限单触点)平均为1.5oz (0,42N) |
| SMT引线共面度(WTOLC):<br>(0,10 mm).004"最大(05-30)<br>(0,15 mm).006"最大(35-50) | 最大配接次数:100+ |

| WTOLC | 4X | 每排引脚数 | 引线式样 | 电镀选项 | Q | 选项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05,10,15,20,25,30,35,40,45,50 | 从图表中指定引线式样 | F =接线柱镀金膜,在焊尾上镀金膜<br>L =触点上镀10u"(0,25μm)的金,焊尾镀金膜 | | A =定位针(不提供LC)<br>LC =锁定夹(不提供A)(需要手动放置)<br>K =(9,00 mm).354"直径的聚酰亚胺膜取放垫<br>TR =卷带封装 |




| 引线式样 | A | 配接高度 |
|---|---|---|
| H02 | (5,59) .220 | (6,35) .250 |
| H12 | (7,24) .285 | (8,00) .315 |
| H22 | (9,25) .364 | (10,00) .394 |
| H32 | (11,23) .442 | (12,00) .472 |




注:某些尺寸、式样和选项为非标准型,不可退换。